

ニュースガイドNo, 10493B

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

無電解貴金属メッキ方法と工程

[公開編]平成21年(1年間) 60点

	(税込価格)	(本体価格)
全文PDF CD-ROM版(抄録版付)	¥18,900-	¥18,000-
全文紙収録 B5製本版	¥18,900-	¥18,000-
CD-ROM版・B5製本版 一括購入	¥28,350-	¥27,000-

既刊関連セットのご案内

No.	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.	点	(本体価格)
No,10201(B)	公開特許	無電解貴金属メッキ方法と工程	平.19	66点	¥23,100
No,10201(A)	"	"	平.18	66点	¥23,100
No,9997(C)	"	"	平.17	84点	¥18,600
No,9997(B)	"	"	平.16	65点	¥19,200
No,9997(A)	"	"	平.15	62点	¥18,300
No,9520	"	"	平.13-14	84点	¥16,800
No,9060	"	"	平.11-12	65点	¥24,200
No,8593	"	"	平.9-10	62点	¥23,700
No,8537	"	無電解ニッケルメッキ方法と浴の組成	平.7-9	65点	¥28,000
No,10199	"	無電解スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.15-19	62点	¥24,885
No,9998	"	スズ合金メッキ方法と浴の組成	平.13-17	100点	¥29,600
No,9189	"	"	平.10-12	68点	¥24,800
No,9088	"	硫酸銅メッキ方法と浴の組成	平.5-12	71点	¥27,700
No,9086	"	銅めっき装置の構造と付属装置	平.5-12	70点	¥27,400
No,9087	"	プリント基板のメッキ処理装置	平.8-12	71点	¥27,700
No,8929	"	メッキ前処理剤の組成と前処理方法	平.5-11	81点	¥31,600
No,8926	"	半田メッキ方法と工程	平.5-11	75点	¥29,700
No,8868	"	半導体ウェーハのメッキ方法と工程	平.5-11	103点	¥35,000
No,9190	"	銀合金メッキ方法と浴の組成	平.5-12	68点	¥24,700
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点	¥23,200

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com)

お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしおりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。]

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイドNo,
	CD-ROM版 or B5製本版 or 一括購入
所属部署名	題名
	合計 ¥
担当者名	E-mail:
	TEL: FAX:
住所: 〒	

料金には別途送料がかかります。

無電解貴金属メッキ方法と工程

No.10493B

[公開編] 平成21年(1年間) 60点

CD-ROM版 ¥18,900 B5製本版 ¥18,900 (全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥28,350)

- | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|----|--|-----------------|
| 1 | 金属コーティング方法および金属リングの製造方法 | 独立行政法人理化学研究所 | 27 | めっき方法及びその方法に用いられるめっき前処理液。 | 日本化学産業株式会社 |
| 2 | 無電解パラジウムめっき液 | 小島化学薬品株式会社 | | 金属ナノ粒子を用いた表面処理方法、その表面処理方法を用いて表面処理された器具 | 有限会社アイビーネット |
| 3 | 金めっき皮膜の封孔処理剤およびその利用 | 四国化成工業株式会社 | 30 | 導電性無電解めっき粉体の製造方法 | 日立化成工業株式会社 |
| 4 | 化学研磨剤及びその化学研磨剤を用いてめっき前処理した銅又は銅合金を用いる金属めっき方法 | メルテックス株式会社 | 31 | 電子部品の電極接続方法及び電子部品 | 大研化学工業株式会社 |
| 5 | 成形回路部品の製造方法 | 三共化成株式会社 | 32 | 無電解めっき方法 | 三菱電機株式会社 |
| 6 | 金属多孔質構造体 | 積水化学工業株式会社 | 33 | Pd - Agの同時メッキによる水素分離用薄膜及びその作製方法 | 独立行政法人産業技術総合研究所 |
| 7 | コアシェル型銀錫複合粒子の製造方法及びコアシェル型銀錫複合粒子並びに黒色材料、黒色遮光膜・・・ | 住友大阪セメント株式会社 | 34 | 導電性材料前駆体および導電性材料 | 三菱製紙株式会社 |
| 8 | 金属パターン形成体の製造方法 | 大日本印刷株式会社 | 35 | めっき層構造とその製造方法 | 株式会社村田製作所 |
| 9 | 金ナノ粒子 - ハロイサイトナノチューブおよびその形成方法 | クワンジュ・インスティテュート・オブ・サイエンス・アンド・テクノロジー | 36 | めっき液及び電子部品 | 石原薬品株式会社 |
| 10 | めっき方法、めっき処理液及び導電性パターンシート | ユニカミルタホールディングス株式会社 | 37 | 無電解めっき方法と電子部品 | 株式会社村田製作所 |
| 11 | 耐食導電被覆材料及びその用途 | 日本カーリット株式会社 | 38 | 導電性微粒子の製造方法、及び、導電性微粒子 | 積水化学工業株式会社 |
| 12 | 置換金メッキ浴及び当該金メッキ方法 | 石原薬品株式会社 | 39 | シリコンを母材とする複合材料及びその製造方法 | 独立行政法人科学技術振興機構 |
| 13 | 多孔質体表面のめっき方法 | トヨタ自動車株式会社 | 40 | 導電粒子及び導電粒子の製造方法 | 日立化成工業株式会社 |
| 14 | 接続端子の製造方法とその接続端子を用いた半導体チップ搭載用基板の製造方法 | 日立化成工業株式会社 | 41 | 金属ナノワイヤー及びその製造方法、並びに水性分散物及び透明導電体 | 富士フイルム株式会社 |
| 15 | 金めっき構造体の製造方法 | トヨタ自動車株式会社 | 42 | 金めっき皮膜構造、金めっき皮膜形成方法およびガラスセラミック配線基板 | 三菱電機株式会社 |
| 16 | 接続端子とその接続端子を用いた半導体チップ搭載用基板及び半導体チップ搭載用基板の製造方法並びに無・・・ | 日立化成工業株式会社 | 43 | メッキ構造体及びメッキ構造体の製造方法 | 積水化学工業株式会社 |
| 17 | 導電粒子、絶縁被覆導電粒子及びその製造方法、異方導電性接着剤 | 日立化成工業株式会社 | 44 | 無電解金めっき液および無電解金めっき方法 | 日立化成工業株式会社 |
| 18 | 導電体の製造方法及び導電体 | 日立化成工業株式会社 | 45 | 無電解めっき前処理剤及びセラミック基材への電極形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 |
| 19 | 貴金属被膜およびそれを用いた宝飾品や装飾品、アパレル製品、電子機器製品とそれらの製造方法 | 有限会社ががわ学生ベンチャー | 46 | めっき装置およびめっき方法 | 三菱電機株式会社 |
| 20 | 銅拡散防止用バリア膜、同バリア膜の形成方法、ダマシン銅配線用シード層の形成方法及びダマシン銅配線・・・ | 日鉱金属株式会社 | 47 | 銀鏡層形成方法、及び銀鏡層を有する炭素繊維複合材 | 有限会社レベルコ |
| 21 | 密着性の促進 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ、エル・エル・シー | 48 | 表層に貴金属を固定させた樹脂基板、その製造方法、回路基板、及びその製造方法 | トヨタ自動車株式会社 |
| 22 | パターンめっき及びパターンめっきの形成方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 49 | 無電解金めっき方法 | 日立化成工業株式会社 |
| 23 | 無電解パラジウムめっき反応開始促進前処理液、この前処理液を用いた無電解めっき方法、無電解めっき方・・・ | 日立化成工業株式会社 | 50 | 金属膜および金属配線パターンの形成方法、金属膜および金属配線パターン形成用下地組成物および・・・ | オムロン株式会社 |
| 24 | 銅素地用置換金めっき液及びそれを用いる金めっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 51 | 導電性回路の形成方法 | ハリマ化成株式会社 |
| 25 | 無電解メッキによるスズホイスキアの防止方法 | 石原薬品株式会社 | 52 | 無電解パラジウムめっき液 | 日鉱金属株式会社 |
| 26 | 金属膜の製造方法 | オムロン株式会社 | | | |

以下6点省略